第一图书网, tushu007.com

<<实用电镀技术>>

图书基本信息

书名：<<实用电镀技术>>

13位ISBN编号：9787502534905

10位ISBN编号：7502534903

出版时间：2002-1-1

出版时间：化学工业出版社

作者：黄子勋

页数：355

字数：310000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书共12章。
主要阐述电镀技术的基本原理、生产工艺和各最新进展。
书中除介绍常用的电镀方法外，也包括用电镀方法制备新型材料的实际应用和最近的研究。
　全书系统的叙述了电镀工艺的各个有关方面，并该领域目前指导实践的基本概念、生产经验和科研成果。
论述简明扼要，资料丰富，内容方便实用。
　本书要供从事腐蚀防护、电镀生产、材料科学等方面从事实际 工作的工程技术人员、研究和教学人员以及大专院校师生参考。

<<实用电镀技术>>

书籍目录

第1章 绪论 1．1 概述 1．2 分类和应用第2章 沉积原理 2．1 概述 2．2 镀液体系 2．3 电结晶过程第3章 工艺参数 3．1 概述 3．2 电位与电流分布 3．3 镀液与工艺选择 3．4 阳极 3．5 表面完整性第4章 工艺流程 4．1 概述 4．2 工艺流程 4．3 前后处理与有关工艺第5章 电镀溶液 5．1 概述 5．2 单体镀层第6章 合金镀层 6．1 概述 6．2 铜基合金 6．3 锌基合金 6．4 镉基合金 6．5 锡基合金 6．6 镍基合金 6．7 贵金属合金 6．8 三元合金 6．9 四元合金第7章 复合镀层 7．1 概述 7．2 复合镀原理 7．3 复合镀工艺 7．4 复合镀层第8章 电铸 8．1 概述 8．2 模芯 8．3 电铸 8．4 脱模第9章 化学镀 9．1 概述 9．2 化学镀原理 9．3 化学镀溶液 9．4 化学镀合金 9．5 化学复合镀第10章 其他镀覆方法 10．1 概述 10．2 浸镀和接触镀 10．3 刷镀 10．4 机械镀 10．5 高速镀 10．6 复合多层薄膜第11章 化合物和半导体材料的沉积 11．1 概述 11．2 阴极上化合物的形成 11．3 半导体合物的沉积 11．4 金属间化合物的沉积 11．5 超导体料的电镀制备 11．6 元素半导体 11．7 电泳和有机物的沉积 11．8 表面着色第12章 质量监控 12．1 概述 12．2 质控要求 12．3 检测方法 12．4 电脑应用与最优化

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com